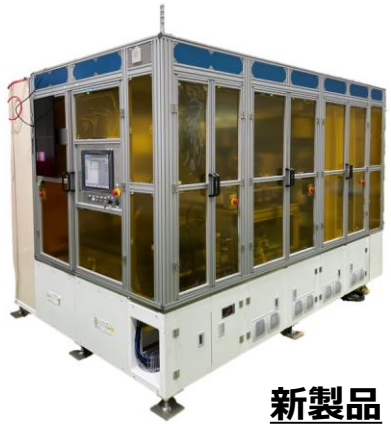
資料

Optical Bonding [常圧貼合／DFシリーズ]　モデル一覧

	バッチタイプ		半自動
	Model①	Model②	Model③
装置サイズ　※参考値	W1200×L1800×H2200 mm	W2500×L2500×H2200 mm	W1200×L2850×H2250 mm
対応パネル	CG/TSG＋LCD/LCM	CG/TSG＋LCD/LCM ガラス+調光ウインドウ	CG/TSG＋LCD/LCM
対応サイズ（W×L）	450×690 （6inch~30inchクラス ）	1500×500 （最大60inchクラス）	160×210 （4inch~8inchクラス）
パネル形状	平面/2.5D/3D	平面/2.5D/3D	平面
アライメント方式	メカニカル または CCD＋精密ステージ （精度はご要望に応じて決定）		
樹脂硬化方式	貼合直後のエリア照射 または ラインスキャン照射（水銀キセノンランプ／紫外線LED）		
オプション	ダム／シール塗布・硬化、保護フィルム剥離、プラズマ処理、自動供給排出、生産管理システム etc.		
外観 （写真又は３D図）	 **DF1**	 **新製品**	 **DF4**
サイクルタイム	90sec ~ /P	10min ~ /P	30sec~45sec/P